

3 证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称	<u>2025年4月25日</u> Neuberger Berman Asia Limited、Pictet Asset Management、博时基金、国泰基金、华泰资管、民生加银基金等 <u>2025年4月29日</u> 公开业绩说明会
时间	2025年4月25日、2025年4月29日
调研方式	线上及线下会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、CFO、董事会秘书：施文茜
投资者关系活动主要内容介绍	

公司介绍

芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。

公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。

基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。

基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。

芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。此外，根据 IPnest 在 2024 年 5 月的统计，2023 年，芯原半导体 IP 授权业务市场占有率位列中国第一，全球第八；2023 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的 IP 分类和各企业公开信息，芯原 IP 种类在全球排名前十的 IP 企业中排名前二。

	<p>2024 年上半年，半导体产业逐步复苏，得益于公司独特的商业模式，即原则上无产品库存的风险，无应用领域的边界，公司自二季度起，经营情况快速扭转。公司 2024 年第二季度营业收入规模同比恢复到受行业周期影响前水平，2024 年第三季度营业收入创历年第三季度收入新高，同比增长 23.60%，第四季度收入同比增长超 17%，全年实现营业收入 23.22 亿元，基本与 2023 年持平。截至 2024 年末，公司订单情况良好，在手订单 24.06 亿元，较三季度末的 21.38 亿元进一步提升近 13%，在手订单已连续五季度保持高位。从新签订单角度，2024 年第四季度公司新签订单超 10.8 亿元，2024 年下半年新签订单总额较 2024 年上半年提升超 50%，较 2023 年下半年同比提升超 48%，较半导体行业周期下行及去库存影响下的 2023 年上半年大幅提升超 80%，对公司未来的业务拓展及业绩转化奠定坚实基础。</p>
<p>交流问答</p>	<p>问题：请问公司目前云服务提供商、互联网厂商等客户的合作情况如何？</p> <p>回复：近年来，系统厂商、互联网公司、云服务提供商、车企因成本、差异化竞争、创新性、掌握核心技术、供应链可控等原因，越来越多地开始设计自有品牌的芯片。这类企业因为芯片设计能力、资源和经验相对欠缺的原因多寻求与芯片设计服务公司进行合作。随着公司提供硬件和软件完整系统解决方案的能力不断提升，迎合了系统厂商、互联网企业、云服务提供商和车企等客户群体的需求，2024 年度来自上述非芯片公司客户群体的收入达到 9.17 亿元，占总收入比重约四成。</p> <p>问题：请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？</p> <p>回复：保持技术领先是芯原的立足之本，能吸引到顶尖人才和客户，塑造良好的品牌和声誉。芯原将持续对半导体 IP、系统级芯片定制平台和软件开发平台的高研发投入，形成一批具有自主知识产权的专利技术。针对关键市场的技术发展趋势，芯原将不断丰富和优化自有的处理器 IP、</p>

射频 IP、IP 子系统和相关的 IP 平台解决方案等。芯原将持续推进多款 5nm/4nm 芯片的设计研发，以及软硬件协同、芯片设计和封装设计协同的技术研发，并根据市场需求，持续研发和升级面向关键应用领域的芯片定制平台和系统级解决方案。

未来，公司将在持续优化迭代已有核心技术的基础上，进一步针对 AIGC、智慧汽车、智慧可穿戴设备等几个关键应用领域，以及 Chiplet 技术进行了深入的技术研发和产业化推进。

公司订单情况良好，截至 2025 年一季度末，公司在手订单金额为 24.56 亿元，创公司历史新高，在手订单已连续六季度保持高位，对公司未来的业务拓展及业绩转化奠定坚实基础。

问题：请问公司在 ASIC 领域有哪些技术储备和布局？

回复：公司的主营业务之一为一站式芯片定制服务，在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验，目前已实现 5nm 系统级芯片一次流片成功，多个 5nm/4nm 一站式服务项目正在执行。同时，公司还提供芯片设计相关的全套软件解决方案。

芯原的芯片设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证，可从芯片和 IP 的设计实现、软件开发等方面，为全球客户满足功能安全要求的车载芯片提供一站式定制服务。结合公司自有的丰富的车规级 IP 组合，以及完整的智慧驾驶软件平台框架，芯原可为客户提供从芯片设计、验证到车规认证的全流程支持，包括安全需求分析、架构设计和认证支持等。

基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等始终在线（Always-on）的轻量化空间计算设备，AIPC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。此外，为了应对先进封装技术可能出现的供应和成本等问题，芯原已针对新一代面板级封装（Panel level package）技术进行了先行设计开发，为接下来的规模量产做好了准备。

芯原一站式芯片定制服务的整体市场认可度不断提高，已开始占据有利地位，经营成果不断优化，特别是当英特尔、博世、恩智浦、亚马逊、谷歌、微软等众多在其各自领域具有较强的代表性和先进性的国内外知名企业成为芯原客户并且形成具有较强示范效应的服务成果后，公司在品牌方面的竞争能力进一步增强。

问题：请问公司如何看待半导体行业未来的发展前景？

回复：目前，半导体产业已进入智能手机后的下一个发展周期，其最主要的发展动力源自于人工智能、大数据、云计算、5G 通信、物联网、智慧汽车和新能源等新应用的兴起。根据 IBS 报告，全球半导体市场在 2023 年市场规模为 5,237 亿美元，而上述应用将驱动着该市场在 2030 年达到 11,834 亿美元，呈稳定快速增长态势。

具体来看，AI、汽车和可穿戴市场的发展潜力和空间较大。例如，近几年主要的半导体消费增长驱动力为含服务器和 HPC 系统在内的数据中心，AIGC 在云端训练时所需的算力系统，以及 AIPC 等端侧计算设备的逐步渗透；由于电动汽车市场的快速增长和汽车的数字化与智慧化演进，汽车应用中的半导体消费出现了高速增长；此外，AR 眼镜等可穿戴设备正在不断向低功耗、轻量化和高算力演进，并受到 AIGC 相关技术快速发展的推动，其市场也逐步从游戏、教育、电商、工业类应用市场，向更加

	<p>广阔的以社交为中心的消费类市场拓展，市场规模持续扩大。</p>
--	------------------------------------